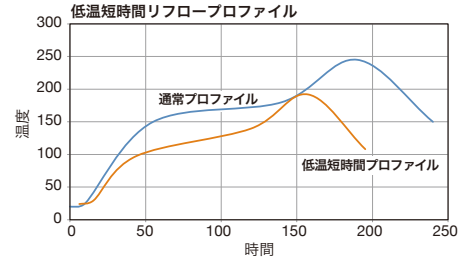


PETフィルムが、プリント基板材料に使えるようになりました

PET film is now available as a PCB material

特長

- 弱耐熱部品や基板が実装でき、材料コストの大幅な削減に期待
- 丸めても十分な接合強度を得る低温実装には、L20-JPPが最適
- 低温短時間プロファイルなど、省エネに貢献する環境配慮製品
- M705などと組み合わせた実装で、再溶融を防止



Revolutionary Products

低温実装を推進するはんだ材料をラインナップ、環境配慮と低コスト化を推進



L20 フロー用ソルダバー

低温フローはんだ付けを可能にした



世界初

LEO L20 ソルダコールド

硬くて脆い合金をやに入り&伸線加工した



L20 ソルダボール

弱耐熱材料へのバンブ形成に



L20&L27-LT142 ソルダペースト

低温短時間リフロープロファイルを可能にした



L20 ソルダプリフォーム

再溶融を防止する、低温で後付けするシールドケースに



L20-JPP ソルダペースト

フラックス残渣が接着材として接合強度を補強、フレキシブル基板に最適な

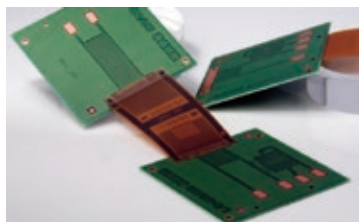
● 200°Cでもはんだ付け可能

世界初、硬くて脆い合金を伸線加工したLEO



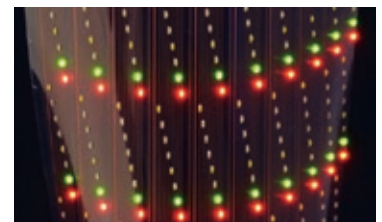
● リフローでの低温実装例

弱耐熱基板を高強度接合したL20-JPP



フレキシブル基板

PENフィルム基板にLEDをL20-JPPで実装



PENフィルム フレキシブル基板